(54) RESIN COMPOSITION

HEAT-RESISTANT IC TRAY

(11) 4-288363 (A)

(43) 13.10.1992 (19) JP

(21) Appl. No. 3-77258 (22) 18.3.1991

(71) ASAHI CHEM IND CO LTD (72) KEIICHI NAKAZAWA(1)

(51) Int. Cl⁵. C08L71/12,C08J5/00,C08K3/04,C08L53/02//C08L53/00,C08L71/12

PURPOSE: To obtain the title composition improved in conductivity, moldability and heat (aging) resistance by mixing a polyphenylene ether resin with two specified block copolymers and conductive carbon.

CONSTITUTION: 100 pts.wt. mixture comprising 10-99wt.% polyphenylene resin having a number-average molecular weight of 1000·100000 and at least 0.01 terminal ring group of the formula (wherein R₁ to R₅ are each H, (substituted) alkyl, halogen or (substituted) aryl; and R₆ to R₇ are each R₁, (substituted) alkenyl, alkoxy, N-lactarm or the like)) on the average per 100 phenylene ether units, 90·1wt.% block copolymer comprising 50·90wt.% vinylaromatic compound polymer blocks (A) and olefin compound polymer blocks (B) and having a degree of unsaturation of 20% or below, and 0·10wt.% block copolymer comprising 20·50wt.% component A and component B having a degree of unsaturation of 20% or below is mixed with 3·40 pts.wt. conductive carbon.

(54) POLYAMIDE COMPOSITION

(11) 4-288364 (A)

(43) 13.10.1992 (19) JP

(21) Appl. No. 3-77049

(22) 15.3.1991

(71) TOYOBO CO LTD (72) TSUTOMU TAMURA(1)

(51) Int. Cl⁵. C08L77/00,C08K5/09//(C08L77/00,C08L71/02)

PURPOSE: To obtain a polyamide composition improved in injection molability by depositing a specified copolymer and then a higher fatty acid salt of a group I-III metal of the periodic table on the surface of a polyamide chip.

CONSTITUTION: The title composition is obtained by depositing 0.01·0.5wt.% normally liquid propylene oxide/ethylene oxide block or random copolymer having an absolute viscosity (at 30°C) of 10·1000cP and an ethylene oxide content of 20·60wt.% on the surface of a polyamide chip (e.g. nylon 6 chip) in the form of a cylinder of a diameter of 1.5·3.0mm and a height of 1.5·3.0mm or a plate of a depth of 1.5·3.0mm, a width of 1.5·3.0mm and a height of 1.5·3.0mm and further depositing thereon 0.01·0.5wt.% higher fatty acid salt of a group I·III metal of the periodic table (e.g. magnesium stearate).

(54) PHOTOPOLYMER MATERIAL

(11) 4-288365 (A)

(43) 13.10.1992 (19) JP

(21) Appl. No. 3-78587

(22) 18.3.1991

(71) SHIN ETSU CHEM CO LTD (72) HIROSHIGE OKINOSHIMA(1)

(51) Int. Cl⁵. C08L79/08,C08F283/04,C08K5/21,G02F1/1337,G03F7/027,G03F7/038,H01L21/312

PURPOSE: To obtain a photopolymer material which is improved in storage stability and an ability to form a thick film and can give a coating film excellent in photosensitivity and its stability by mixing a specified polymer with a urea compound.

CONSTITUTION: The title material is obtained by mixing a polymer mainly consisting of repeating units of formula I (wherein X is a trivalent or tetravalent organic group; Y is a bivalent organic group; and n is 1-2) with 0.2-1.5 mol equivalents, in relation to the COOH groups of the polymer, urea compound of formula II (wherein R' is a group having a functional group which can be dimerized or polymerized by irradiation with light or a radiation; and R² and R³ are each H or a monovalent organic group) as a photosensitive component and optionally a sensitizer having a function of sensitizing the photosensitive group of the urea, a polymerization initiator having a function of initiating polymerization, a photopolymerizable or photodimerizable compound, a functional alcoxilane compound, etc.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-288365

(43)公開日 平成4年(1992)10月13日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	F I			技術表示箇所
C08L	79/08	LRB	9285-4 J				
C08F	283/04	MQT	7142-4 J				
C 0 8 K	5/21						
G02F	1/1337	5 2 5	8806-2K				
G 0 3 F	7/027	514	9019-2H				
				審査請求	未請求	: 請求項の数1(全17頁)	最終頁に続く
(21)出願番		特顧平3-78587		(71)	出願人	000002060	
						信越化学工業株式会社	
(22)出願日		平成3年(1991)3	月18日			東京都千代田区大手町二丁	目6番1号
				(72)	発明者	沖之島 弘茂	
						群馬県安中市磯部2丁目13	番1号 信越化
						学工業株式会社シリコーン	電子材料技術研
						究所内	
				(72)	発明者	加藤 英人	
						群馬県安中市磯部2丁目13	番1号 信越化
						学工業株式会社シリコーン	電子材料技術研
						究所内	
				(74)	代理人	弁理士 小島 隆司	

(54) 【発明の名称】 感光性重合体材料

(57)【要約】

【目的】 保存安定性が良好であり、感光性、感度安定 性及び厚膜形成性に優れた強膜を形成できる感光性重合* *体材料を得る。

【構成】 下記一般式(1)

【化1】

(但し、式中Xは3価又は4価の有機基、Yは2価の有 機基であり、nは1又は2である。) で表される繰り返 し単位を主成分として含有する重合体と、(2)下配一 **般式(II)**

【化2】

R' - NCON - R'R'

···· (II)

(但し 式中R1は光又は放射線で二量化又は重合可能 な官能基を有する基、R²、R³はそれぞれ水素原子又は 1価の有機基である。) で表されるウレア結合を有する 化合物とを配合する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (1) 下配一般式(1)

(但し、式中Xは3価又は4価の有機基、Yは2価の有機基であり、nは1又は2である。)で表される繰り返し単位を主成分として含有する重合体と、(2)下配一般式(II)

【化2】

H R' - NCON - R'R' (II)

(但し 式中R¹ は光又は放射線で二量化又は重合可能な官能基を有する基、R²、R² はそれぞれ水素原子又は1価の有機基である。)で表されるウレア結合を有する化合物とを配合してなることを特徴とする感光性重合体材料

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体素子表面保護 膜、半導体素子用絶縁膜、液晶表示素子用配向膜、多層 プリント基板用絶縁膜等として有用なポリイミド系樹脂 強膜を与える感光性重合体材料に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、トランジスタ、IC、LSI等の 半導体案子の保護膜や多層配線間の層間絶縁膜としてポ リイミド系樹脂材料が使用されている。このポリイミド 系樹脂材料は上述のような半導体素子の製造に利用する 場合、スルーホール形成等の微細加工が必要であるが、 この微細加工プロセスの合理化を目的として感光性耐熱 材料として使用し得るポリイミド系樹脂材料の検討が行 われ、下配材料が提案されている。

- (1) ポリアミック酸と重クロム酸塩とからなる材料 (特公昭49-17374号公報)
- (2) ポリアミック酸のカルボキシ基にエステル結合に より感光基を導入した化合物からなる材料(特公昭 5 5 -30207号公報)
- (3) ポリアミック酸と感光基を有するエポキシ基含有 化合物とを反応させることにより得られる化合物からな 40 る材料(特開昭55-45746号公報)
- (4) ポリアミック酸と感光基を有するアミン化合物と からなる材料(特公昭54-145794号公報) **

% [0003]

【化1】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述した(1)の材料は可使時間が著しく短い上、生成ポリイ 10 ミドフィルム中にクロムイオンが不純物として残存し、

(2) の材料においても感光基を導入するために脱塩酸 反応が用いられることから生成ポリイミドフィルム中に 塩素イオンが残存するため、いずれも純度の点で問題が あった。また、(3)の材料では主成分となる化合物に イオン性不鈍物の混入なしにエステル結合によって感光 基の導入が可能であるが、感光基の導入率が低く、感度 の面で実用上問題であった。更に、(4)の材料におい ては、イオン性不純物の混入が無い上、十分な量の感光 基を導入できるといった利点を有する反面、露光前の感 光性重合体材料溶液から溶剤を揮散させるプリベークの 段階で材料溶液に混合しておいた感光成分が一部揮発し てしまったり、厚膜を形成する際にやはりプリベークの 段階で溶剤が揮散することによって感光成分がポリアミ ック酸の貧溶剤として働き、塗膜の白化現象を引き起こ し、その後の工程が困難となるといった問題を有してい た。

【0004】本発明は上記問題点を解決するためになされたものであり、イオン性不純物の混入がほとんどなく、保存安定性に優れ、しかも加熱硬化後に感光性が良 30 好で感度の安定性及び厚膜形成性に優れた高品質のポリイミド系樹脂強膜を与える感光性重合体材料を提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段及び作用】本発明は上記目的を解決するため鋭意検討を重ねた結果、下記一般式(I)で表される繰り返し単位を主成分として含有する重合体と下記一般式(II)で表される化合物とを配合することにより、優れた保存安定性を有し、かつ感光性、感度安定性及び厚膜形成性に優れ、半導体案子表面保護膜等として有用なポリイミド系強膜を与える感光性重合体材料を与えることを見い出した。

[0006]

[化3]

(但し、式中Xは3価又は4価の有機基、Yは2価の有

機基であり、nは1又は2である。)

[0007]

(但レ 式中R¹ は光又は放射線で二量化又は重合可能な官能基を有する基、R²、R³ はそれぞれ水来原子又は1価の有機基である。) この場合、感光成分として上記

*耐熱性、電気的・機械的特性の良好な強膜を与えるものである。

【0008】従って、本発明は、上配(I)式の繰り返し単位を主成分として含有する重合体と、上配(II)式のウレア結合を有する化合物とを配合してなる感光性重合体材料を提供する。

【0009】以下、本発明につき更に詳述すると、本発明の第一必須成分である重合体は、下配一般式(I)で 示される繰り返し単位を有するポリイミド系的駆体であ

存しても粘度変化が小さく、かつ、良好な感光性、加熱 (0010) 処理後のパターン保持性、厚膜形成性を有し、しかも、* (化5)

(但し、式中Xは3価又は4価の有機基、Yは2価の有機基であり、nは1又は2である。)

[0011] [化6] ここで、(1) 式中のXは酸無水物残基から導かれるものであり、例えばXが

フェノンテトラカルボン酸二無水物残基、Xが

場合3,3'4,4' - ビフェニルテトラカルボン酸二無水物残基、X が

る場合ビス (3,4' - ジカルボキシフェニル) ジメチルシランジアンヒドリド

ルボキシフェニル) 1.1.3.3 - テトラメチルジシロキサンジアンヒドリド残基な どが挙げられる。

なお、Xは上記酸無水物残基の1種であっても2種以上 の組み合わせであっても良い。

【0012】一方、Yは2価の有機基でH₂N-Y-N H₂のジアミンから導かれるものであり、このようなジ アミンの例としては、p-フェニレンジアミン、m-フ ェニレンジアミン、4,4'-ジアミノジフェニルメタ ン、4,4'-ジアミノジフェニルエーテル、2,2' ーピス (4-アミノフェニル) プロパン、4,4'-ジ アミノジフェニルスルホン、4,4'-ジアミノジフェ ニルスルフィド、1, 4-ビス(3-アミノフェノキ シ) ベンゼン、1, 4-ピス(4-アミノフェノキシ) ベンゼン、1, 4-ピス (m-アミノフェニルスルホニ ル) ベンゼン、1, 4-ピス (p-アミノフェニルスル ホニル) ペンゼン、1、4-ピス (m-アミノフェニル チオエーテル) ペンゼン、1, 4-ピス (p-アミノフ ェニルチオエーテル) ベンゼン、2, 2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]プロパン、2,2 50 ロプロパン等の通常炭素数6~20の芳香族環合有ジア

-ピス[3-メチル-4-(4-アミノフェノキシ)フ ェニル] プロパン、2, 2-ピス[3-クロロ-4-(4-アミノフェノキシ) フェニル] プロパン、1, 1 - ピス [4-(4-アミノフェノキシ) フェニル] エタ ン、1、1-ビス[3-メチル-4-(4-アミノフェ ノキシ) フェニル] エタン、1, 1-ピス[3-クロロ 40 -4-(4-アミノフェノキシ)フェニル] エタン、 1, 1-ピス[3, 5-ジメチル-4-(4-アミノフ ェノキシ) フェニル] エタン、ピス [4-(4-アミノ フェノキシ) フェニル] メタン、ピス [3-メチル-4 - (4-アミノフェノキシ) フェニル] メタン、ピス [3-クロロ-4-(4-アミノフェノキシ)フェニ ル] メタン、ピス [3, 5-ジメチル-4-(4-アミ ノフェノキシ) フェニル] メタン、ピス [4-(4-ア ミノフェノキシ)フェニル]スルホン、2,2-ピス [4-(4-アミノフェノキシ) フェニル] パーフルオ

ミン、更にそれぞれ下記式に示されるようなアミノ基、 アミド基の核置換基を有するジアミンやポリアミン或い はシリコンジアミン等が挙げられるが、これらに限定さ

はシリコンシアミン等か挙げられるか、これらに放定されるものではない。また、Yは上記ジアミン残基の1種であっても2種以上の組み合わせであってもよい。

7

[0013]

【0014】 【化7】

$$\begin{array}{ccc} CH_s & CH_0 \\ \downarrow & \downarrow \\ H_2N \longrightarrow (CH_2)_{\overline{s}} Si = O = Si \longrightarrow (CH_2)_{\overline{s}} NH_2 \ , \\ \downarrow & \downarrow \\ CH_n & CH_s \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} CH_s & CH_s \\ & | & | \\ H_2N \longrightarrow (CH_2)_{\overline{4}} Si - O - Si \longrightarrow (CH_2)_{\overline{4}} NH_2 \ , \\ & | & | & | \\ CH_s & CH_s \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc} C_{6}H_{5} & C_{6}H_{5} \\ | & | & | \\ H_{2}N - (CH_{2})_{3} - Si - O - Si - (CH_{2})_{3} - NH_{2} \\ | & | & | \\ CH_{3} & CH_{3} \end{array},$$

$$\begin{array}{cccc} CH_3 & CH_3 \\ | & | & | \\ H_2N & CH_2 & Si & (O-Si)_{18} & (CH_2)_3 & NH_2 \\ | & | & | & | \\ CH_4 & CH_8 & CH_8 & \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c} CH_s & CH_s \\ \hline \\ -OCH_2Si - O - SiCH_2O - \\ CH_s & CH_s \end{array},$$

$$\begin{array}{ccc} CH_3 & CH_3 \\ \downarrow & & \downarrow \\ H_2N \longrightarrow (CH_2)_3 & Si \longrightarrow CH_2 \longrightarrow Si \longrightarrow (CH_2)_3 & NH_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ CH_3 & & CH_3 \end{array}$$

9

【化8】

[0015]

$$\begin{array}{c} CH_3 / CH_3 \\ H_2N - (CH_2)_3 / Si - (O-Si - (CH_2)_4 / NH_2) \\ CH_3 / CH_3 / SS \end{array}$$

$$H_zN \longrightarrow O - Si \longrightarrow NH_s$$

$$CH_s \quad CH_s \quad CH_s$$

$$\begin{array}{c|c} CH_s & CH_s \\ \vdots & O - Si \\ CH_s & CH_s \end{array},$$

$$\begin{array}{c|c} CH_{8} & CH_{2} \\ CH_{2} & CH_{2} CH_{2} - CH_{3} \\ CH_{3} & CH_{3} \end{array} NH_{2}$$

$$\begin{array}{c} CH_{s} \\ CH_{s$$

$$\begin{array}{c|c} CH_{s} & CH_{s} \\ CH_{s} & CH_{s}O & OCH_{s}O & OCH_{s}O$$

[0016]

*ここで、(II) 式中のR¹は光又は放射線で二量化又

は重合可能な官能基を有する基であり、例えば下配の基

$$CH_3$$
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3

- 次に、第二必須成分として用いる化合物は、下記一般式 (II) で示されるウレア結合を有するものである。

[0017]

【化10】



[0018]

【化11】

が挙げられる。

$$CH_2 = CH - CH_2 = CH - CH_2 - CH_2 = CH - C - O - CH_2CH_2 - CH_2 - CH_2$$

$$CH_a = C - C - OCH_aCH_2 -$$
, $CH_a = C - C - O - CH_aCH_aCH -$
 $CH_a O$ $CH_a O$

$$\bigcirc - CH = CH - C - O - CH_2CH_2 - , CH_2 = CH - CNCH_2CH_2 -$$

また、R²、R³はそれぞれ水素原子又は1価の有機基で 30% 【0019】

あり、その中に二量化又は重合可能な官能基を含むこと 【化12】

もできるもので、何えば下記の基が挙げられる。

R², R³共にH, - CH₂, - CH₂CH₃, -**〈(⌒)**〉 及び上記 R¹ と同様の基

このような化合物 (II) として具体的には、下記の化 [0020]

合物を挙げることができる。

【化13】

$$\begin{array}{c} HO \\ | \ | \ \\ CH_2 = CH - CH_2 - NCNH_2 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} & \text{HOH} \\ \mid \parallel \mid \\ \text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_2 \text{NCNCH}_3 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} HO\\ \parallel \parallel\\ CH_z=CH-CH_z-NCN \end{array} (CH_0)_2$$

$$HOH$$

$$| | | | |$$

$$CH_2 = CH - CH_2 - NCN - CH_2 - CH = CH_2$$

$$CH_2 = CH - C - O - CH_2CH_2NCNH_2$$

$$CH_{2} = CH - C - O - CH_{2}CH_{2}NCN (CH_{3})_{2}$$

$$O$$

$$CH_{2} = CH - C - O - CH_{2}CH_{2}NCNCH_{2}CH_{2} - O - C - CH = CH_{2}$$

$$CH_2 = C - C - O - CH_2CH_2NCNH_2$$

$$CH_2 = C - C - O - CH_2CH_2NCNCH_8$$

[0021]

【化14】

$$\bigcirc -CH = CH - C - O - CH_2CH_2NCNH_2$$

$$\bigcirc -CH = CH - C - O - CH_2CH_2NCNCH_3$$

$$\bigcirc -CH = CH - C - O - CH_2CH_2NCNCH_3$$

$$\bigcirc -CH = CH - C - O - CH_2CH_2NCN-(CH_3)_2$$

【0022】 【化15】

[0023] [化16]

$$CH = CH + CH_{2}C - OCH_{2}CH_{2}NCNH_{2}$$

$$CH_{2} = \begin{array}{ccc} CH_{3} & H & HO \\ & & & & \\ CH_{2} = C - CNCH_{2}CH_{2}NCNH_{2} \\ & & & \\ O \end{array}$$

なお、これら化合物は1種類を単独で用いても2種類以上を併用してもよい。

【0024】化合物(II)の配合量は、種々選定し得るが、(I)式の重合体中のカルポキシル基(-COO H基)に対して0.2~1.5モル当量、特に0.4~1.2モル当量とすることが好ましい。配合量が0.2モル当量より少ない場合は光感度の低下を引き起こす場合があり、1.5モル当量を超えると最終熱処理時での30膜べりが大きいといった問題が生じる場合がある。

【0025】更に、本発明では上記(II)式の化合物 の感光基に対して感光作用のある増感剤又は重合開始作 用のある重合開始剤を配合することが好ましい。この増 越剤及び重合開始剤としては、例えばペンゾイン、2-メチルペンゾイン、ペンゾインメチルエーテル、ペンゾ インエチルエーテル、ペンゾインイソプロピルエーテ ル、ベンゾインプチルエーテル、2-1-プチルアント ラキノン、1,2-ペンゾ-9,10-アントラキノ ン、アントラキノン、メチルアントラキノン、4,4' - ピス(ジエチルアミノ)ペンゾフェノン、アセトフェ ノン、ペンゾフェノン、チオキサントン、1,5-アセ ナフテン、2、2-ジメトキシ-2-フェニルアセトフ ェノン、1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケト ン、2-メチルー [4-(メチルチオ) フェニル] 2-モルフォリノー1ープロパノン、2ーペンジル-2-ジ メチルアミノー1- (4-モルホリノフェニル) -プタ ノン、ジアセチル、ペンジル、ペンジルジメチルケター ル、ペンジルジエチルケタール、ジフェニルジスルフィ ド、アントラセン、2-ニトロフルオレン、ジベンザル 50 類以上を併用してもよい。

アセトン、1-ニトロピレン、1,8-ジニトロピレ ン、1,2-ナフトキノン、1,4-ナフトキノン、 1, 2-ペンズアントラキノン、ミヒラーズケトン、 4, 4'-ピスー(ジエチルアミノ)ーペンゾフェノ ン、2,5-ピス-(4'-ジエチルアミノペンザル) ーシクロペンタノン、2、6~(4'-ジエチルアミノ ベンザル) 4-メチル-シクロヘキサノン、4,4'-ピスー (ジメチルアミノ) ーカルコン、4,4'ーピス - (ジエチルアミノ) -カルコン、4-ジメチルアミノ シンナミリデンインダノン、4-ジメチルアミノペンジ リデンインダノン、2-(4'-ジメチルアミノフェニ ルピニレン) ーペンゾチアゾール、2-(4'-ジメチ ルアミノフェニルピニレン) -イソナフトチアゾール、 1, 3-ピス-(4'-ジメチルアミノペンザル)-ア セトン、1、3-ピス-(4'-ジエチルアミノベンザ ル) -アセトン、3,3'-カルポニルーピスー(7-ジエチルアミノクマリン)、7-ジエチルアミノ-3-40 ペンゾイルクマリン、7-ジエチルアミノー4-メチル クマリン、N-フェニルージエタノールアミン、N-p ートリルージエチルアミン、2,6-ジ(p-アジドベ ンザル) -4-メチルシクロヘキサノン、2,6-ジ (p-アジドベンザル)シクロヘキサノン、4、4'-ジアジドカルコン、4,4'-ジアジドペンザルアセト ン、4、4'-ジアジドスナルペン、4、4'-ジアジ ドベンゾフェノン、4、4'-ジアジドジフェニルメタ ン、4,4'-ジアジドフェニルアミンなどが挙げられ る。なお、これら化合物は1種類を単独で用いても2種

【0026】上記増感剤及び光重合開始剤の配合量は、 (I) 式の重合体及び(II) 式の化合物の合計量に対 して0.01~20重量%、特に0.05~15重量% とすることが好ましく、0.01重量%に満たないと光 感度が十分で無い場合があり、20重量%を超えると逆 に光感度が低下する場合がある。

【0027】更に、本発明材料には感光性向上を目的と して光重合又は光二量化が可能な化合物を共重合モノマ ーとして添加することが可能であり、具体的には2-エ リレート、N-ピニル-2-ピロリドン、2-ジメチル アミノエチルメタクリレート、2-ジエチルアミノエチ ルメタクリレート、N-メチルーピス(メタクリロキシ エチル) アミン、カルビトールアクリレート、テトラヒ ドロフルフリルアクリレート、イソボルニルアクリレー ト、1,6-ヘキサンジオールジアクリレート、ネオペ ンチルグリコールジアクリレート、エチレングリコール ジアクリレート、ポリエチレングリコールジアクリレー ト、ペンタエリスリトールジアクリレート、トリメチロ ールプロパントリアクリレート、ペンタエリスリトール 20 トリアクリレート、ジベンタエリスリトールヘキサアク リレート、テトラメチロールメタンテトラアクリレー ト、テトラエチレングリコールジアクリレート、ノナエ チレングリコールジアクリレート、メチレンピスアクリ ルアミド、N-メチロールアクリルアミドや、これらの アクリレート又はアクリルアミドをメタクリレート又は メタクリルアミドに変えたもの等が挙げられ、これらの 中で特にエチレングリコールジアクリレート、トリメチ ロールプロパントリアクリレート、メチレンピスアクリ ルアミド等の2つ以上の炭素-炭素に二重結合を有する 30 化合物が好適に用いられる。なお、これら共重合モノマ 一の添加量は、(I)式の重合体及び(II)式の化合 物の合計量に対して10重量%以下、特に1~5重量% とすることが好ましく、10重量%を超えるとプレヒー ト後の強膜に白濁が生じる場合がある。

【0028】本発明の感光性重合体材料には、必要に応 じて官能性アルコキシシラン化合物を添加することがで きる。この官能性アルコキシシラン化合物は、重合体材 料が形成する耐熱性高分子膜とこの膜で被覆する基体と して用いるS1及び無機絶縁膜との界面の接着性を向上 40 させ得るものであり、何えばァーアミノプロピルメチル トリメトキシシラン、N-β- (アミノエチル) - r-アミノプロピルジメトキシシラン、ァーグリシドキシブ ロピルメチルトリエトキシシラン等が挙げられる。これ ら官能性アルコキシシラン化合物の添加量は、(I)式 の重合体及び(II) 式の化合物の合計量の0.1~5 重量%、特に0.5~3重量%とすることが好ましい。

【0029】また、本発明材料には溶液状態とした場合 の保存安定性を向上させるために重合禁止剤を添加する ことが好ましい。 重合禁止剤としては、例えばハイドロ 50 などの溶媒を混合して用いてもよい。 更に、現像終了後

キノン、ヒドロキノンモノメチルエーテル、N-ニトロ ソジフェニルアミン、p-tert-プチルカテコー ル、フェノチアジン、N-フェニルナフチルアミン、 2, 6-ジーtertープチルーpーメチルフェノール 等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。 なお、重合禁止剤の添加量は、(I)式の重合体及び (11)式の化合物の合計量の5重量%以下、特に0. 5 重量%以下とすることが望ましい。

【0030】本発明の感光性重合体材料は、全成分を溶 チルヘキシルアクリレート、2-ヒドロキシエチルアク 10 解し得る溶媒に溶解して所定の基体上に塗布して用いる ことができる。この際、基体との密着性を高めるため に、前配アルコキシシラン化合物を基体にプレコートし て用いることもできる。

> 【0031】前記溶媒としては極性溶媒が好ましく、例 えばジメチルホルムアミド、N-メチルピロリドン、ジ メチルアセトアミド、ジグライム、酢酸イソプチル、シ クロベンタノンなどが挙げられ、更にアルコール、芳香 族炭化水素、エーテル、ケトン、エステルなどの溶媒を 成分を析出させない範囲で加えることもできる。基体上 に塗布する方法としては、前記のようにして得られた感 光性重合体材料溶液をフィルターで濾過した後、例えば スピンコーター、パーコーター、プレードコーター、ス クリーン印刷法等で基体に塗布する方法、基体を該溶液 に浸漬する方法、該溶液を基体に噴霧する方法などを用 いることができる。

> 【0032】次に、このようにして得られた強膜を風 乾、加熱乾燥、真空乾燥などを組み合わせて乾燥した 後、通常フォトマスクを通して露光を行う。この際に用 いる活性光線としては、例えば紫外線、X線、電子線等 が挙げられ、これらの中で紫外線が好ましい。その光源 としては、例えば低圧水銀灯、高圧水銀灯、超高圧水銀 灯、ハロゲンランプ等が挙げられ、これらの光源の中で 超高圧水銀灯が好適である。なお、露光は窒素雰囲気下 で行うことが好ましい。

> 【0033】このようにして露光した後、未照射部を除 去すべく、浸漬法やスプレー法等を用いて現像を行う。 この際に用いる現像液としては、未露光膜を適当な時間 内に完全に溶解除去し得るようなものが好ましく、例え ばN-メチルピロリドン、N-アセチル-2-ピロリド ン、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチル アセトアミド、ジメチルスルホキシド、ヘキサメチルホ スポリックトリアミド、N-ペンジル-2-ピロリド ン、アープチロラクトンなどの非プロトン性極性溶媒を 単独で用いてもよいし、或いはこれらに第2成分として **例えばエタノール,イソプロパノールなどのアルコー** ル、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素化合物、 メチルエチルケトン、メチルイソプチルケトンなどのケ トン、酢酸エチル、プロピオン酸メチルなどのエステ ル、テトラヒドロフラン、ジオキサンのようなエーテル

はその直後に第2成分として使用できる上述のような密 棋でリンスすることが好ましい。

【0034】このようにして現像により形成されたレリ ーフ・パターンは(I)式の重合体が前駆体の形で存在 しており、これを例えば200~450℃で10分間~ 10時間加熱処理するとパターン化されたポリイミド系 樹脂強膜が形成される。この本発明の感光性重合体材料 から得られるパターン化されたポリイミド系樹脂強膜 は、耐熱性に優れ、かつ、電気的・機械的特性が良好な ものである。

[0035]

【発明の効果】本発明の感光性重合体材料は、イオン性 不純物の混入がほとんどなく、保存安定性に優れている 上、安定した感度を有し、容易に厚膜の形成が可能であ り、加熱硬化後に耐熱性、電気的・機械的特性に優れた 高品質のポリイミド系樹脂塗膜を与える。従って、本発 明材料は、例えば半導体素子上に光によって直接微細な パターンを形成することが可能であり、ジャンクション コート膜、パッシベーション膜、パッファーコート膜、 間絶縁膜のような半導体素子用絶縁膜、液晶表示素子用 配向膜、多層プリント基板用絶縁膜などとして好適に利 用することができる。

[0036]

蘇光性

良: 現像、リンス後の残膜率が 80%以上

不良: 現像、リンス後の残膜率が 80%未満

また、上記感光性重合体溶液を5℃で6ヶ月放置し、放 30 置前と放置後の粘度をオストワルド粘度計で測定して保 存安定性を評価した。以上の結果を表5に併記する。

24

【実施例】以下、実施例及び比較例を挙げて本発明を具 体的に説明するが、本発明は下配実施例に制限されるも のではない。なお、以下の例において部はいずれも重量 部である。

【0037】 [実施例1~8、比較例] 下配の表1~3 にそれぞれ示した重合体、感光剤、増感剤及び重合開始 剤を用い、表5に示す組成、配合量で混合した後、N-メチルー2-ピロリドン400部に溶解し、感光性重合 体溶液(実施例1~8)を調製した。

【0038】また、上記感光剤の代わりに表4に示す化 合物を使用し、表5に示す組成、配合量で上配と同様に して感光性重合体溶液(比較例)を調製した。

【0039】これら感光性重合体溶液をシリコンウェハ 一上にスピンコート(1500rpm/12sec.) し、70℃で1時間乾燥して表5に示す膜厚の均一な塗 膜を得た。次に、この強膜を窒素雰囲気下でマスクを通 して高圧水銀灯(2kW)を用いて10秒間露光した。 露光後、N-メチル-2-ピロリドンとキシレンの当量 混合液にウェハーを浸漬し、更にキシレンでリンスして α線遮蔽膜等の半導体素子表面保護膜や多層配線用の層 20 乾燥した後の露光性、及び、このウェハーを150℃で 1時間、更に、350℃で1時間加熱した後の膜質を下 記基準で評価した。

[0040]

加熱後の膜質

クラック、剥離なし

クラック、剥離発生

[0041] 【表1】

25 26 略号 重 合 体 の 構 造 ÇН₃ ÇH₃ CH_a **С**ОН НОС О П О P-2СОН [0042] 【表2】

—530—

略号	底	光	剤	Ø	樽	造
U – 1		CH ₂ = C		– CH₄CH	HO aNCNHa	
U — 2		$\left(CH^{3}=C\right)$	сн , С – С – С) – CH₃Cl	H ₂ N + C	
U – 3	CH ₂	CH ₈ = C - C -	· O – CH.	HO ;CH₂NCN	—-(CH₂C	CH ₃) ₂

[0043]

【表3】

略号	増感剤及び重合開始剤の名称							
S-1	ミヒラーズケトン							
S – 2	2,6 - ジ(p - アジドベンザル) - 4 - メチルシクロヘキサノン							
s – a	2-メチル-[4-(メチルチオ)フェニル]-2- モルホリノ-1-プロパノン							
S – 4	2ーベンジルー2ージメチルアミノー1ー (4ーモルホリノフェニル)ーブタノン							
S-5	2-イソプロピルチオキサントン							
S – 6	3,3゜ーカルボニルービスー(7 -ジエチルアミノクマリン)							

[0044]

【表4】

略号	感	光	剤	の	樽	造	•
A – 1	CH	CH ₃ = C -	C – OCH	I ₂ CH ₂ N—	-(CH ₈) ₂		

[0045]

【表5】

29						30			
		重合体 (I) (配合 量・部)	感光剤 (配合量・部)	増盛剤 重合開始剤 (配合量・部)	重合禁止剤 (配合量・部)	塗布 膜厚 (μm)	感光性	加熱後膜質	6ヶ月後 粘度 (cs) 初期粘度 (cs)
	1	P - 1	U – 1	S-1 , S-2	ヒドロキノンモノメチ	25	良	良	3200
		(100)	(65)	(5) (5)	ルエーテル (0.15)				3400
	2	P - 1 (100)	U – 1 (65)	S-3 , S-5 (8) (2)	ヒドロキノ ンモノメチ ルエーテル	2 5	良	良	3350
			, , , ,		(0.15)				3400
	3	P - 1 (100)	U – 1 (65)	S-4 (8)	ヒドロキノ ンモノメチ ルエーテル	25	良	良	3350
		(100)	(00)	(0)	(0.15)				3400
実	4	P - 1 (100)	U – 1 (52)	S-4 , S-6 (8) (0.5)	ヒドロキノ ンモノメチ ルエーテル	22	良	良	3000
		(100)	(32)	(0) (0.0)	(0.15)				3150
施	5	P - 1 (100)	U – 2 (65)	S-4 (8)	ヒドロキノンモノメチルエーテル	23	良	良	2950
, m		((55)	(-)	(0.15)				3100
例	6	$\begin{array}{c cccc} P-1 & U-1 & U-2 \\ \hline (100) & (52) & (21) \end{array}$		ヒドロキノ ンモノメチ ルエーテル	25	良	良	3250	
			(02) (21)	(0) (2)	(0.15)				3350
	7	P - 1 (100)	U – 3 (85)	\$-3 , \$-5 (8) (2)	ヒドロキノ ンモノメチ ルエーテル	25	良	良	2950
		(100)	(00)	(0) (2)	(0.15)				3100
	8	P - 2		\$-3 , \$-5	ヒドロキノンモノメチルエーテル	28	良	良	4450
		(100)		(9) (2)	ルエーテル (0.15)				4800
		P - 1 (100)	A - 1 (60)	S-3 , S-5 (8) (2)	ヒドロキノ ンモノメチ ルエーテル	21	不宜	_	2400
ØI		(100)	(00)	(8) (2)	(0.15)		良		2700

表5の結果より、本発明の感光性重合体材料(実施例1 ~8)は、良好な感光性、加熱処理後のパターン保持性 を有する強膜を与え、厚膜形成も可能である上、6ヶ月 保存後の粘度変化が10%以内で良好な保存安定性を有することが確認された。更に、得られた塗膜は、耐熱性、電気的・機械的特性が良好であった。

フロントページの続き

 51) Int. Cl. 8
 識別記号
 庁内整理番号

 G 0 3 F
 7/038
 5 0 4
 7124-2H

 H 0 1 L
 21/312
 D
 8518-4M